

THERMOFLO 1500

NAJNOWSZEJ GENERACJI

SYSTEM MONTAŻOWO-DEMONTAŻOWY

DLA UKŁADÓW **BGA**



PAGE[®]
WORLDWIDE

THERMOFLO 1500 stworzono by umożliwić łatwy i bezpieczny montaż i demontaż elementów takich jak BGA, PBGA, CBGA, μ BGA, CSP, FC, MLF, LCC i innych.

Dzięki precyzyjnemu układowi optycznemu o wysokiej rozdzielczości dokładne wypoźycjonowanie elementów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

- Intuicyjne, łatwe w obsłudze oprogramowanie, zapewniające operatorowi zawsze skuteczne przeprowadzenie procesu
- Szybkie i precyzyjne konfigurowanie nawet bardzo złożonych profili
- Całość procesu odbywa się bez przemieszczania płytki lub komponentu
- Podgrzewanie płytki promiennikami IR oraz dużej wydajności głowica konwekcyjna pozwalają na efektywną pracę z "trudnymi termicznie" płytkami
- Możliwość obsługi płytek o maksymalnych wymiarach do 305x305mm
- Wbudowany kompresor, standardowo wyposażony w opcję zasilania azotem
- Atrakcyjna cena

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE MONTAŻU I DEMONTAŻU UKŁADÓW W OBUDOWACH BGA I POCHODNYCH (PBGA, μ BGA, CSP, FLIP CHIP)



- ◆ 10 lat doświadczeń
- ◆ Bezpłatne prezentacje i szkolenia
- ◆ Długie gwarancje i bezpłatny serwis
- ◆ Natychmiastowa realizacja zamówień
- ◆ Uznani światowi producenci
- ◆ Tysiące zadowolonych klientów

THERMOFLO 3000



Precyzyjny, programowalny system do montażu i demontażu PBGA, CSP, LGA, LCC oraz innych komponentów SMD. Idealny do poprawek poprodukcyjnych, serwisu, prac projektowych i produkcji krótkoseryjnej. Rozbudowana wersja THERMOFLO 1500

XR 3000



Stołowe urządzenie rentgenowskie przeznaczone do kontroli montażu elementów elektronicznych - szczególnie BGA/CSP. Oprogramowanie do dokumentowania i archiwizowania zdjęć.

KESTREL



Kestrel jest wysokiej jakości bezkontaktowym systemem pomiarowym łączącym w sobie szereg zalet wśród, których najważniejszymi są:

- dokładność i powtarzalność pomiarów,
- wyraźny obraz,
- szybkość pracy,
- łatwość obsługi,
- niska cena.